

**NEW** (開発品)

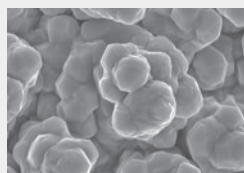
# 接着パーフロロ樹脂EA-2000



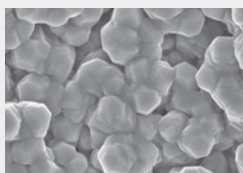
■ 高機能フッ素樹脂PFAと同等の耐熱性、耐薬品性をそのままに、接着性が付与されました。従来に無かったプリント基板用途展開が可能となります。

■ 特長 ・耐熱性： ハンダリフロー耐性を有する (260℃以上)  
・電気特性： 極めて低い誘電率 (2.1) ・誘電正接 (0.001)

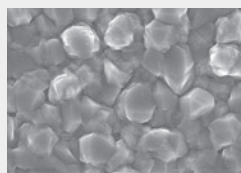
■ 樹脂に特別な化学処理等の表面処理を施すことなく、プロファイルフリー銅箔、及び無粗化銅箔との接着が可能



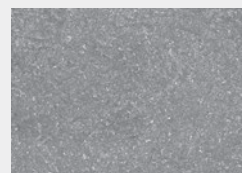
一般銅箔  
Rz=7.0~8.0μm



ロープロファイル銅箔  
Rz=2.5~3.5μm



プロファイルフリー銅箔  
Rz=1.0~1.5μm



無粗化銅箔  
Rz=1.0μm以下

	表面粗度 Rz (μm)	表面粗度 Rq (μm)	EA-2000フィルム Peel強度 (N/cm)
一般銅箔	7.2	1.45	13
ロープロファイル銅箔	3	0.25	11
プロファイルフリー銅箔	1.2	0.19	12
無粗化銅箔	0.9	0.13	12

※各数値は保証値ではなく代表値になります

■ EA2000基板はPTFE基板より優れた伝損特性を示す

測定周波数	5GHz (Ave.)	25GHz (Ave.)
EA2000基板 (ガラスクロス含)	0.0053	0.014
PTFE基板 (ガラスクロス含)	0.0090	0.030

※各数値は保証値ではなく代表値になります